

半導體工程系 碩士在職專班 111 學年度入學課程結構規劃表

課程類別		一年級						二年級					
		第一學期			第二學期			第一學期			第二學期		
		課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數
必修	應修課程數 5 門/ 應修學分數 14 學分	微電子工程科技	3	3	工程科技專論	3	3	論文	6	6	論文	6	6
		專題研究(一)	1	1	專題研究(二)	1	1						
專業課程 選修	應修學分數 至少 16 學分	光電工程	3	3	高等真空技術	3	3						
		奈米材料	3	3	電源系統設計	3	3						
		太陽能工程	3	3	發光二極體專論	3	3						
		高等微機電工程	3	3	數位積體電路設計	3	3						
		半導體感測元件	3	3	高等太陽能光電工程	3	3						
		高等半導體元件	3	3	嵌入式系統設計與實務	3	3						
		高等積體電路製程	3	3	射頻與微波電路設計	3	3						
		光電元件量測與分析	3	3									
		高等發光二極體製造技術及應用	3	3									

備註：

- 一、畢業總學分數為 30 學分。
- 二、必修 14 學分，選修 16 學分。
- 三、學生修讀所屬學院之「學院共同課程」應認列為本系專業課程學分；修讀所屬學院之「學院跨領域課程」或其他學院開課之課程，則認列為外系課程學分。
- 四、系所訂定條件（學程、檢定、證照、承認外系學分及其他）：論文，請擇一學期修讀，修畢且及格者方可畢業。

